

2026年01月20日

# 台积电上调 2026 年资本开支，加速现有晶圆厂建设

— 半导体行业周报

## 推荐(维持)

## 投资要点

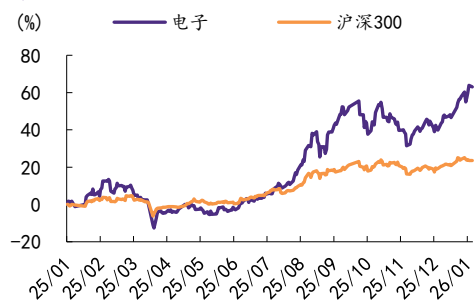
分析师：吕卓阳 S1050523060001

lvzy@cfsc.com.cn

### 行业相对表现

表现	1M	3M	12M
电子(申万)	16.6	18.5	64.7
沪深300	3.6	4.9	24.2

### 市场表现



### 相关研究

- 1、《电子行业周报：英伟达已投产 VeraRubin，xAI 加码算力基建》2026-01-15
- 2、《半导体行业周报：中芯国际拟花 406 亿元收购中芯北方，台积电开始量产 2nm 芯片》2025-12-31
- 3、《电子行业周报：美光退出消费赛道，长鑫 IPO 进程加速，摩尔线程 MUSA 开发者大会开幕》2025-12-24

### 台积电盈利超预期 上调 2026 年资本开支

台积电 2025 年第四季度盈利增长超预期，推动其将 2026 年全年 CAPEX 上调至 520 亿至 560 亿美元，高于 2025 年的 409 亿美元。台积电预计本季度营收同比增长 35.7%至 40%，最高达 358 亿美元。第四季度净利润达 5057 亿新台币（约 160 亿美元），同比增长 35%，主要受 AI 高性能芯片需求强劲拉动。董事长兼 CEO 魏哲家在财报电话会上表示，AI 市场发展对公司持续利好，2025 年 AI 加速器相关收入占总营收比重已达“high-teens（约 17%至 19%）”水平。

### 台积电尽量加速现有晶圆厂建设，美国亚利桑那第三晶圆厂已动工

台积电表示 2 纳米技术在 2025 年第四季度已于新竹和高雄同步开始量产，良率良好，预计 2026 年将快速爬坡。N2P（增强版）计划今年下半年量产。A16（采用超级电轨技术）计划 2026 年下半年量产。为此，台积电正尽量加速现有晶圆厂建设。台积电在美国亚利桑那州的 TSMC Arizona 第二座晶圆厂已完成建筑施工，预计将于今年进行设备搬入和安装工作，量产时间有望提前到 2027 年下半年；第三晶圆厂的建设已经启动，第四座晶圆厂和第一座先进封装设施的施工许可正在申请中；此外台积电刚刚在现有厂区附近购买了第二个大型地块。

建议关注国产半导体产业链：寒武纪、中芯国际、华虹公司、北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、茂莱光学。

### 风险提示

中美“关税战”加剧风险；半导体产业国产化进度不及预期；存储芯片景气度回落。

重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2026-01-16 股价	EPS			PE			投资评级
			2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E	
002371.SZ	北方华创	523.88	10.57	9.93	13.17	67.52	52.75	39.77	未评级
688012.SH	中微公司	377.14	2.61	3.50	5.22	146.16	107.76	72.25	未评级
688037.SH	芯源微	220.45	1.01	0.84	1.71	219.16	263.63	128.96	未评级
688072.SH	拓荆科技	385.68	2.48	3.65	5.99	158.24	105.99	65.15	未评级
688256.SH	寒武纪-U	1424.05	-1.08	5.25	8.05	-1318.56	271.25	176.90	买入
688347.SH	华虹公司	140	0.22	0.37	0.68	639.20	376.34	207.22	未评级
688502.SH	茂莱光学	422.57	0.67	1.22	1.81	628.13	346.97	233.27	未评级
688981.SH	中芯国际	126.99	0.46	0.64	0.78	274.69	198.24	163.12	未评级

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：“未评级”盈利预测取自万得一致预期）。

## 正文目录

1、周观点 .....	5
2、周度行情分析及展望.....	6
2.1、周涨幅排行 .....	6
3、行业高频数据.....	10
4、行业动态.....	16
4.1、存储 .....	16
4.2、半导体 .....	21
5、重点公司公告.....	25
6、风险提示.....	27

## 图表目录

图表 1: 重点关注公司及盈利预测 .....	5
图表 2: 海外半导体龙头估值水平及周涨幅 (%) .....	6
图表 3: 近 5 年中万半导体指数 .....	6
图表 4: 1 月 12 日-1 月 16 日半导体主要指数周涨跌幅比较 (%) .....	7
图表 5: 1 月 16 日半导体主要指数市盈率 (TTM) 比较 .....	7
图表 6: 1 月 12 日-1 月 16 日申万二级行业资金流向情况 .....	8
<b>图表 7: 半导体板块公司周涨幅前十股票</b> .....	9
图表 8: 费城半导体指数近两年走势 .....	10
图表 9: 台湾半导体行业指数近两年走势 .....	10
图表 10: 台湾半导体行业指数近两周走势 .....	10
图表 11: 中国台湾 IC 各板块产值当季同比变化 (%) .....	11
图表 12: 全球半导体销售额 ( (单位: 十亿美元) .....	11
图表 13 全球半导体销售额按地区划分 (单位: 十亿美元) .....	11
图表 14: 全球半导体设备销售额 (十亿美元) .....	12
图表 15: 中国半导体设备及制造半导体器件或集成电路用装置进口数量 (台) .....	12
图表 16: 海外市场半导体设备出口金额 (百万美元) .....	13
图表 17: 国产晶圆代工厂产能、出货量、产能利用率数据 (单位: 片) .....	14
图表 18: DRAM 价格 (单位: 美元) .....	14
图表 19: NAND 价格 (单位: 美元) .....	15
图表 20: 市场主要公司存储营收对比 .....	16
图表 21: 瑞能半导体股权结构 .....	21

# 1、周观点

## (1) 台积电盈利超预期 上调 2026 年资本开支

台积电 2025 年第四季度盈利增长超预期，推动其将 2026 年全年 CAPEX 上调至 520 亿至 560 亿美元，高于 2025 年的 409 亿美元。台积电预计本季度营收同比增长 35.7%至 40%，最高达 358 亿美元。第四季度净利润达 5057 亿新台币（约 160 亿美元），同比增长 35%，主要受 AI 高性能芯片需求强劲拉动。董事长兼 CEO 魏哲家在财报电话会上表示，AI 市场发展对公司持续利好，2025 年 AI 加速器相关收入占总营收比重已达“high-teens（约 17%至 19%）”水平。

## (2) 台积电尽量加速现有晶圆厂建设，美国亚利桑那第三晶圆厂已动工

台积电表示 2 纳米技术在 2025 年第四季度已于新竹和高雄同步开始量产，良率良好，预计 2026 年将快速爬坡。N2P（增强版）计划今年下半年量产。A16（采用超级电轨技术）计划 2026 年下半年量产。为此，台积电正尽量加速现有晶圆厂建设。台积电在美国亚利桑那州的 TSMC Arizona 第二座晶圆厂已完成建筑施工，预计将于今年进行设备搬入和安装工作，量产时间有望提前到 2027 年下半年；第三晶圆厂的建设已经启动，第四座晶圆厂和第一座先进封装设施的施工许可正在申请中；此外台积电刚刚在现有厂区附近购买了第二个大型地块。

建议关注国产半导体产业链：寒武纪、中芯国际、华虹公司、北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、茂莱光学、福晶科技、意华股份、泰嘉股份。

图表 1：重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2026-01-16 股价	EPS			PE			投资评级
			2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E	
002371.SZ	北方华创	523.88	10.57	9.93	13.17	67.52	52.75	39.77	未评级
688012.SH	中微公司	377.14	2.61	3.50	5.22	146.16	107.76	72.25	未评级
688037.SH	芯源微	220.45	1.01	0.84	1.71	219.16	263.63	128.96	未评级
688072.SH	拓荆科技	385.68	2.48	3.65	5.99	158.24	105.99	65.15	未评级
688256.SH	寒武纪-U	1424.05	-1.08	5.25	8.05	-1318.56	271.25	176.90	买入
688347.SH	华虹公司	140	0.22	0.37	0.68	639.20	376.34	207.22	未评级
688502.SH	茂莱光学	422.57	0.67	1.22	1.81	628.13	346.97	233.27	未评级
688981.SH	中芯国际	126.99	0.46	0.64	0.78	274.69	198.24	163.12	未评级

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：“未评级”盈利预测取自万得一致预期）

## 2、周度行情分析及展望

### 2.1、周涨幅排行

1月12日-1月16日当周，海外龙头总体呈上涨态势。其中，超威半导体(AMD)领涨，涨幅为14.11%。

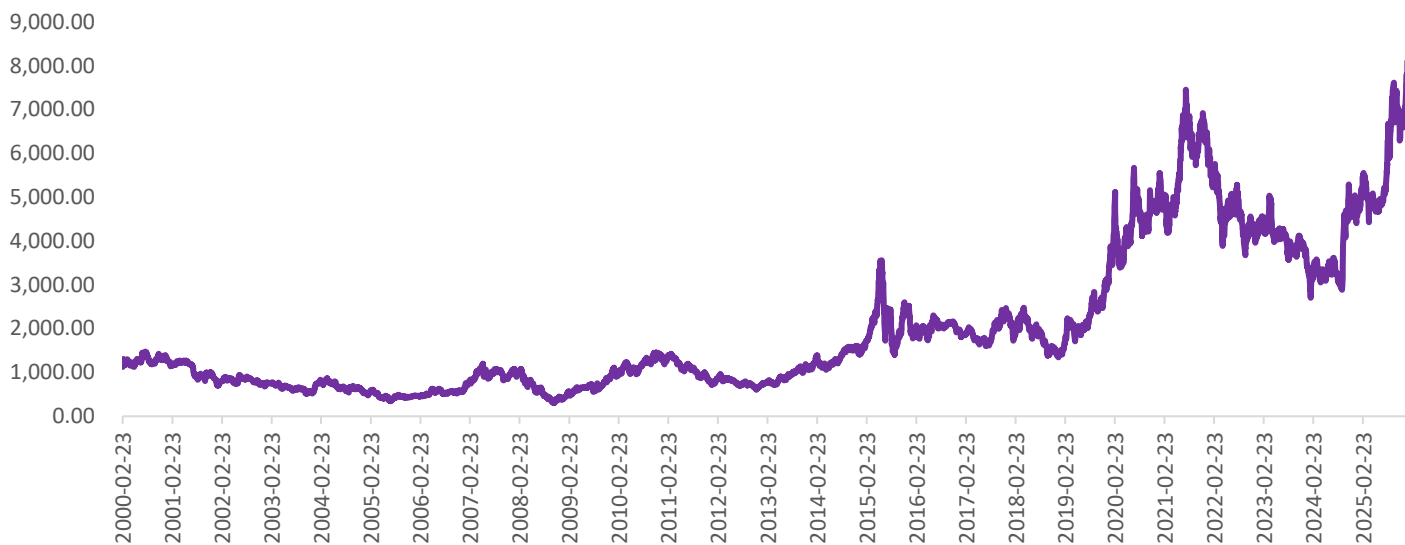
图表 2：海外半导体龙头估值水平及周涨幅 (%)

	证券代码	证券简称	国家/地区	市值(亿元)	PE(LYR)	PB(MRQ)	周涨跌幅 (%)
处理器	INTC.0	英特尔(INTEL)	美国	2239.99	-11.94	2.11	3.10
	QCOM.0	高通(QUALCOMM)	美国	1707.39	30.81	8.05	-10.33
	AMD.0	超威半导体(AMD)	美国	3774.29	230.00	6.21	14.11
	NVDA.0	英伟达(NVIDIA)	美国	45253.89	62.09	38.06	0.74
存储	MU.0	美光科技(MICRON TECHNOLOGY)	美国	4082.78	47.81	6.94	5.12
模拟	TXN.0	德州仪器(TEXAS INSTRUMENTS)	美国	1740.74	36.46	10.47	0.67
	ADI.0	亚德诺(ANALOG)	美国	1470.19	64.84	4.35	-0.23
	AVGO.0	博通(BROADCOM)	美国	16675.53	72.11	20.51	1.95
	NXPI.0	恩智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)	荷兰	596.75	23.77	5.94	-1.68
射频	SWKS.0	思佳讯(SKYWORKS)	美国	85.89	18.00	1.49	-3.99
	QRVO.0	QORVO	美国	74.02	133.09	2.11	-2.04
功率半导体	STM.N	意法半导体	荷兰	250.12	16.06	1.40	-2.81
	ON.0	安森美半导体(ON SEMICONDUCTOR)	美国	242.75	15.43	3.07	-2.94
	IFX.DF	英飞凌科技	德国	544.74	53.67	3.19	0.91
光学	3008.TW	大立光	中国台湾	3243.28	12.51	1.78	-3.95
半导体设备	AMAT.0	应用材料(APPLIED MATERIAL)	美国	2593.00	37.05	12.70	8.58
	LRCX.0	拉姆研究(LAM RESEARCH)	美国	2800.44	52.26	27.47	2.11
	KLAC.0	科天半导体(KLA)	美国	2060.00	50.72	41.32	11.99
	ASML.0	阿斯麦	荷兰	5350.47	67.50	24.11	6.65
硅片	6488.TWO	环球晶圆	中国台湾	2290.16	23.26	2.55	11.53
晶圆代工	2330.TW	台积电	中国台湾	564141.74	26.27	8.33	3.57
	GFS.0	格芯(GLOBALFOUNDRIES)	开曼群岛	229.16	-86.48	1.96	3.77
化合物半导体	3105.TWO	稳懋	中国台湾	926.31	120.59	2.35	0.92
封装	ASX.N	日月光投资	中国台湾	428.62	42.55	4.11	10.03
分销	ARW.N	艾睿电子(ARROW ELECTRONICS)	美国	60.89	15.53	0.95	2.79
	AVT.0	安富利(AVNET)	美国	41.32	17.20	0.85	1.93

资料来源：wind，华鑫证券研究，截至1月16日收盘价

1月12日-1月16日当周，申万半导体指数整体呈现先回落后上涨的态势。1月16日，申万半导体指数为8098.11，本周涨跌幅为5.33%。

图表 3：近 5 年申万半导体指数

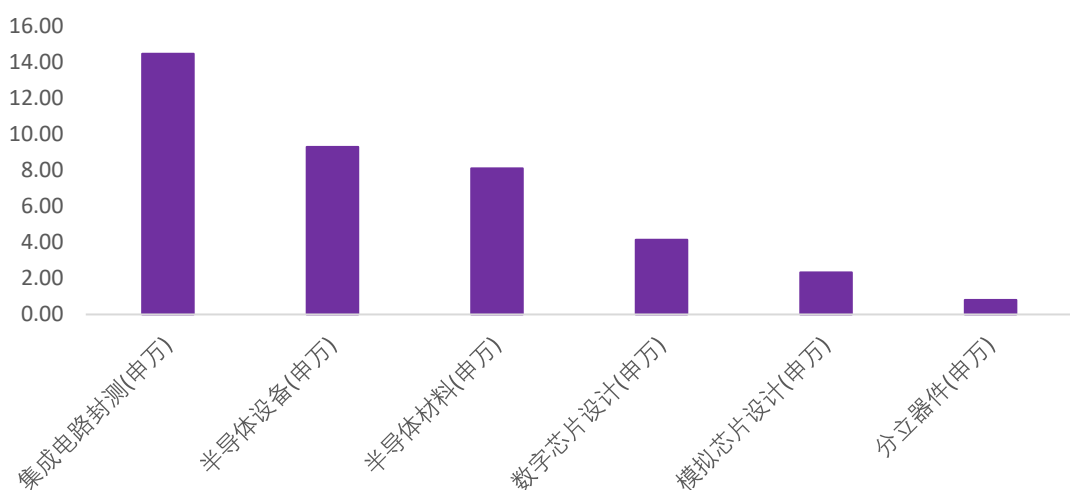


资料来源: wind, 华鑫证券研究

注: 按申万行业二级分类

半导体细分板块比较, 1月12日-1月16日当周, 半导体细分板块呈上涨态势。其中, 集成电路封测板块涨幅最大, 达到 14.47%; 分立器件板块涨幅最小, 达到 0.80%。估值方面, 模拟芯片设计、数字芯片设计、半导体材料板块估值水平位列前三。

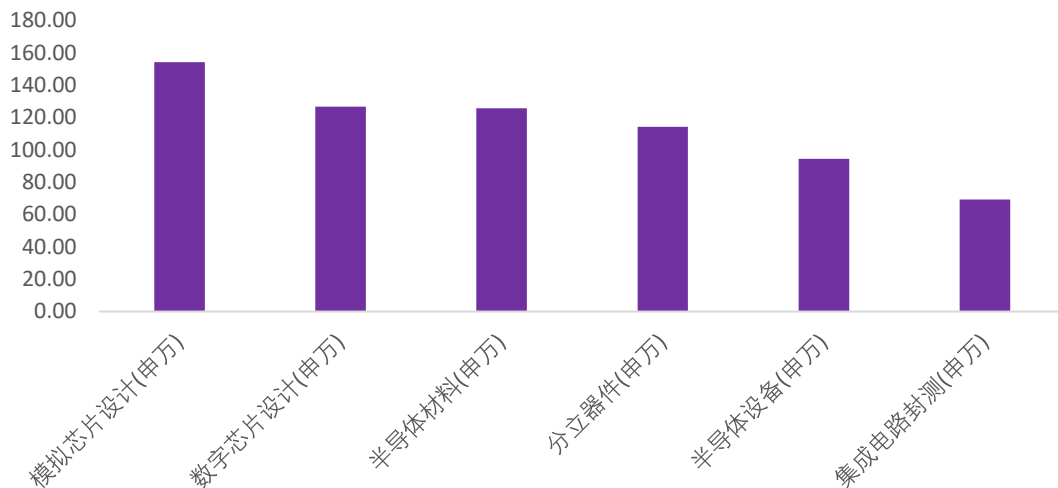
图表 4: 1月12日-1月16日半导体主要指数周涨跌幅比较 (%)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

注: 按申万行业三级分类

图表 5: 1月16日半导体主要指数市盈率 (TTM) 比较



资料来源: wind, 华鑫证券研究

上周半导体相关板块资金流向情况:

半导体板块主力净流出 7.91 亿元, 主力净流入率为-0.06%, 在 9 个二级子行业中排第 1 名; 军工电子板块主力净流出 203.32 亿元, 主力净流入率为-4.02%, 在 9 个子行业中排第 9 名。

图表 6: 1 月 12 日-1 月 16 日申万二级行业资金流向情况

行业	主力流入额(万元)	主力流出额(万元)	主力净流入额(万元)	主力净流入率(%)	连续流入天数
SW 半导体	52,761,768.25	52,840,930.75	-79,162.50	-0.06	2
SW 其他电子 II	5,901,552.00	5,920,997.62	-19,445.61	-0.14	2
SW 电子化学品 II	6,394,422.25	6,491,632.94	-97,210.69	-0.59	-1
SW 通信设备	38,028,656.90	38,978,259.37	-949,602.48	-1.14	-2
SW 消费电子	23,357,582.76	24,228,350.77	-870,768.02	-1.58	2
SW 计算机设备	10,910,119.16	11,413,702.01	-503,582.85	-1.66	-2
SW 航天装备 II	8,519,447.31	9,401,828.12	-882,380.81	-3.97	-4
SW 其他电源设备 II	4,890,236.40	5,455,008.21	-564,771.82	-4.00	-5
SW 军工电子 II	21,196,960.46	23,230,124.23	-2,033,163.77	-4.02	-4

资料来源: wind, 华鑫证券研究

注: 按申万行业二级分类

1 月 12 日-1 月 16 日当周, 半导体板块公司周涨幅前十个股: 蓝箭电子、佰维存储、江波龙、凯德石英、甬矽电子、汇成股份、矽电股份、伟测科技、和林微纳、天岳先进等, 周涨幅分别为 57.66%、45.85%、27.36%、26.14%、24.43%、23.16%、20.91%、20.31%、20.10%、19.62%。

图表 7：半导体板块公司周涨幅前十股票

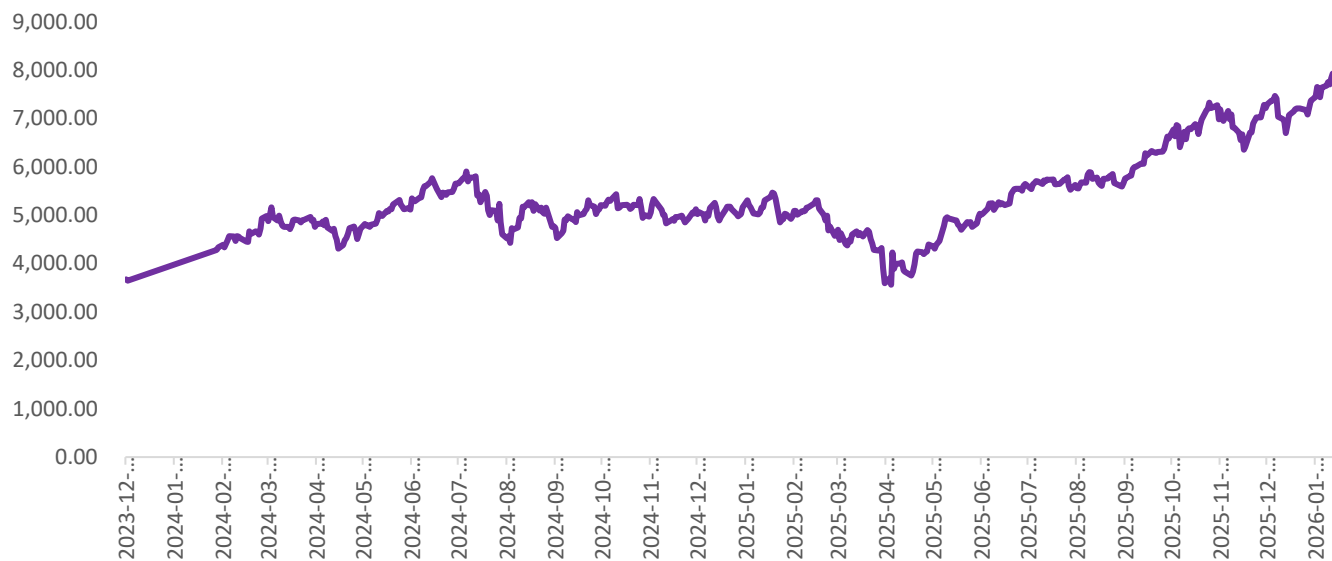
证券代码	证券简称	市值 (亿元)	EPS			PE			PB	周涨跌幅 (%)
			2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E		
301348.SZ	蓝箭电子	82.49	0.08	-	-	545.85	-	-	5.54	57.66
688525.SH	佰维存储	859.52	0.37	1.52	1.85	635.53	-	-	18.78	45.85
301308.SZ	江波龙	1481.59	1.20	1.24	5.02	293.25	288.81	70.40	19.68	27.36
920179.BJ	凯德石英	41.89	0.44	0.46	0.70	103.88	121.43	79.80	5.55	26.14
688362.SH	甬矽电子	214.31	0.16	0.49	0.83	542.39	107.16	63.59	8.40	24.43
688403.SH	汇成股份	193.17	0.19	0.33	0.32	120.91	70.24	69.19	5.48	23.16
301629.SZ	砂电股份	143.04	2.94	2.46	3.23	155.30	139.38	106.21	12.28	20.91
688372.SH	伟测科技	210.17	1.13	2.15	2.76	163.90	85.78	66.93	7.41	20.31
688661.SH	和林微纳	131.61	-0.07	3.49	1.05	-1523.49	42.05	82.26	10.63	20.10
688234.SH	天岳先进	511.21	0.42	0.51	0.70	285.55	210.37	153.52	7.28	19.62

资料来源：wind，华鑫证券研究（注：盈利预测取自万得一致预期，未覆盖标的采用“-”）

### 3、行业高频数据

海外方面，1月12日-1月16日当周，费城半导体指数呈现震荡上行的态势，近两周整体呈现持续上升的态势。更长时间维度上来看，2023年年底开始持续上涨。2024年上半年整体处于上升态势，7月出现大幅回调，8月处于震荡下行行情，9月出现探底回升，四季度总体处于震荡的态势。2025年一季度呈现先涨后跌的走势，4月后逐渐回升，二季度三季度均呈现震荡上行的态势。

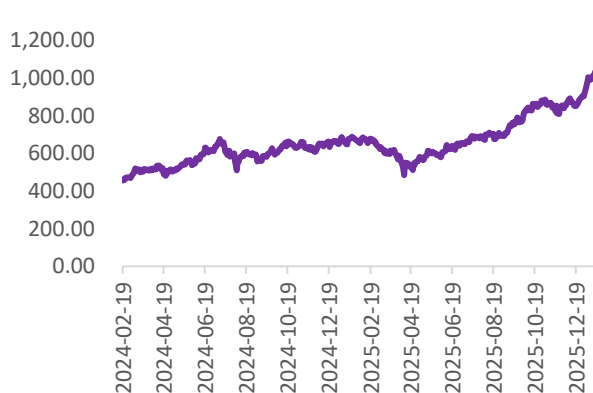
图表 8：费城半导体指数近两年走势



资料来源：wind，华鑫证券研究

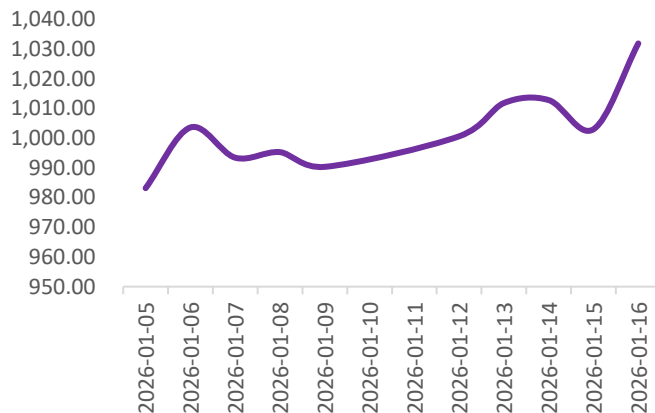
此外，我们选取台湾半导体行业指数来观察行业整体景气。近两周来看，1月5日-1月16日两周，台湾半导体行业指数呈现震荡上行的态势。近两年来看，2024年一季度台湾半导体指数呈现上涨的态势，随后进入震荡行情。2025年一季度台湾半导体指数进入下跌的行情，随后进入上行的态势。

图表 9：台湾半导体行业指数近两年走势



资料来源：wind，华鑫证券研究

图表 10：台湾半导体行业指数近两周走势

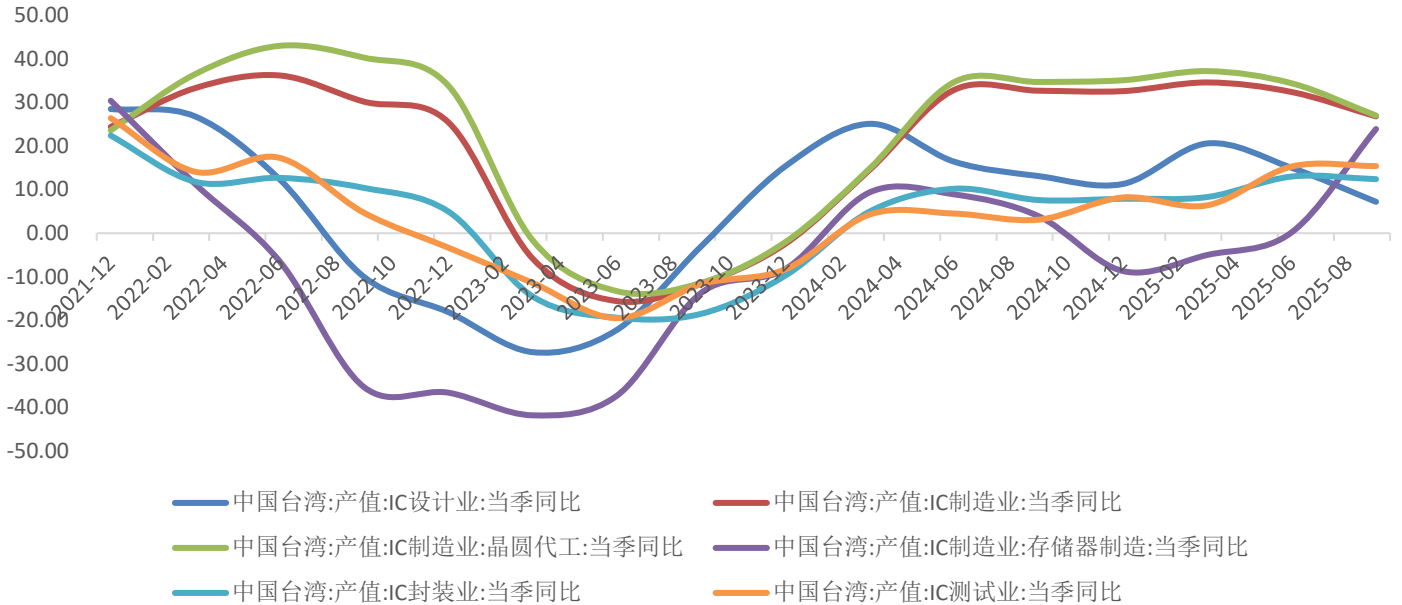


资料来源：wind，华鑫证券研究

我们可以通过中国台湾 IC 产值同比增速，将电子各板块合在一起观察：

中国台湾 IC 各板块产值同比增速自 2021 年以来持续下降，从 2023 年 Q2 开始陆续有所反弹，各板块产值降幅均有所收窄。IC 板块整体表现不佳，主要因为消费电子需求差，导致 IC 设计下滑，加之 2021 年缺货、涨价导致的 2022 年库存水位上升。但随着 AI、5G、汽车智能化等应用领域的推动，2024 年需求开始逐步回升。2025 年，中国台湾 IC 设计、IC 制造以及晶圆代工产值同比增速小幅下滑；中国台湾 IC 封装、测试业产值同比增速为维持平稳的增速；中国台湾存储器制造业进入下半年来，产值同比大幅提升。

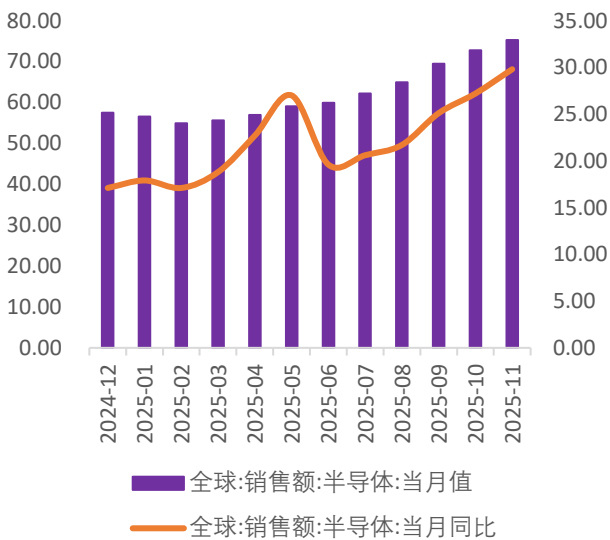
图表 11：中国台湾 IC 各板块产值当季同比变化 (%)



资料来源：wind，华鑫证券研究

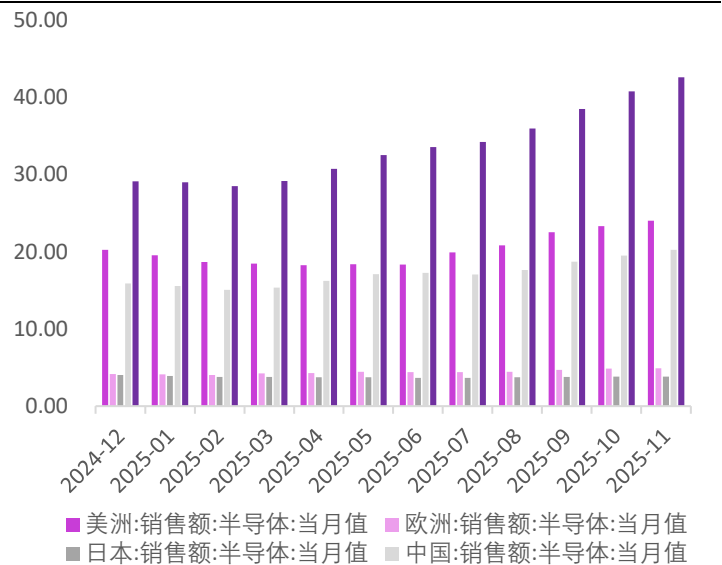
全球半导体销售额自 2024 年年底出现小幅下降。2025 年 4 月以来，全球半导体销售额呈现逐月攀升的态势，半导体行业景气度提升显著，2025 年 6 月增速开始放缓，7-10 月增速开始回升。2025 年 11 月，全球半导体当月销售额为 752.8 亿美元，同比增长 29.80%。其中中国销售额为 202.3 亿美元，环比增长 3.85%，占比达 26.87%。

图表 12：全球半导体销售额（单位：十亿美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

图表 13 全球半导体销售额按地区划分（单位：十亿美元）

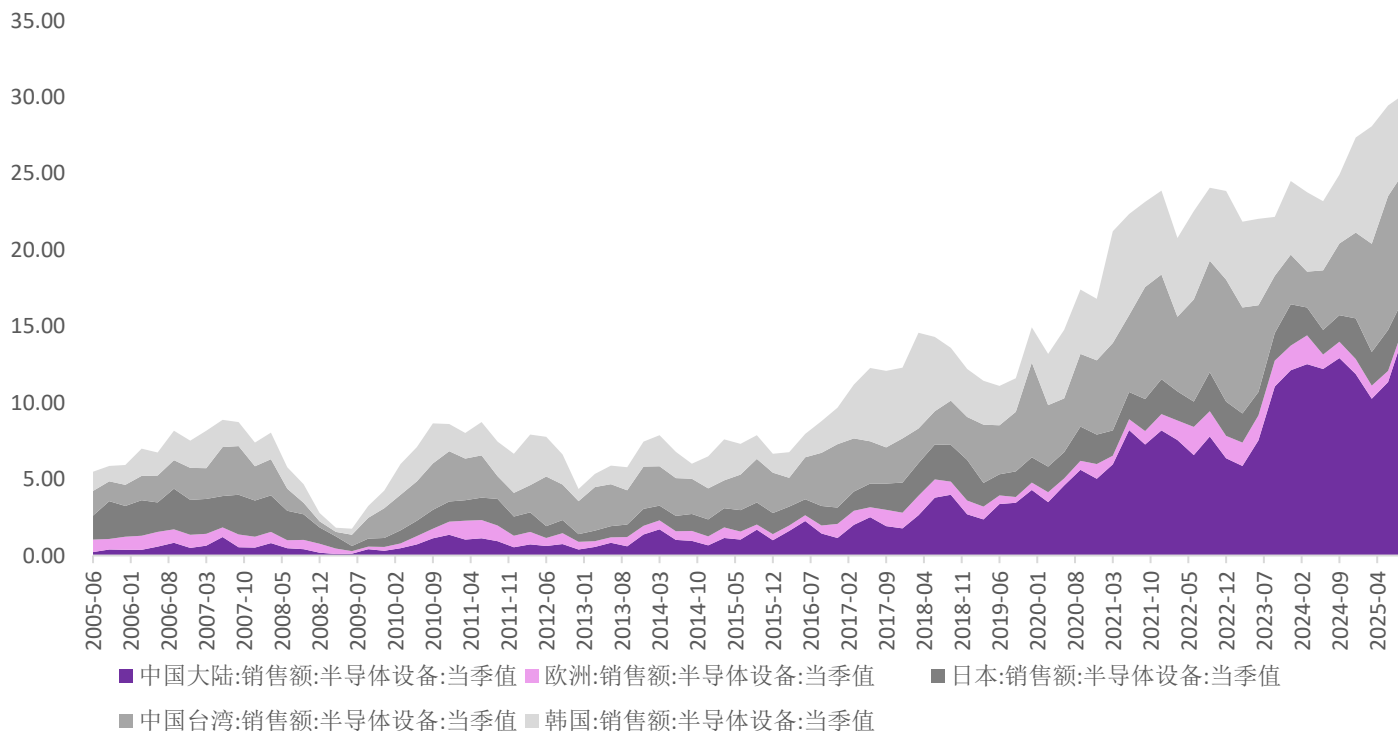


资料来源：wind，华鑫证券研究

2005 年以来，全球主要地区的半导体设备当季销售额呈现上升的趋势。2008~2009 年，受全球金融危机等因素影响，各地区半导体设备销售额大多出现下滑。2020~2025 年，随着 5G、人工智能等技术发展带来的半导体需求增加，全球半导体整体呈现增长态势，中国大陆和中国台湾增长较为显著。

2025 年三季度，中国大陆半导体设备销售额达到 145.6 亿美元，同比增长 12.61%，环比增长 28.17%。

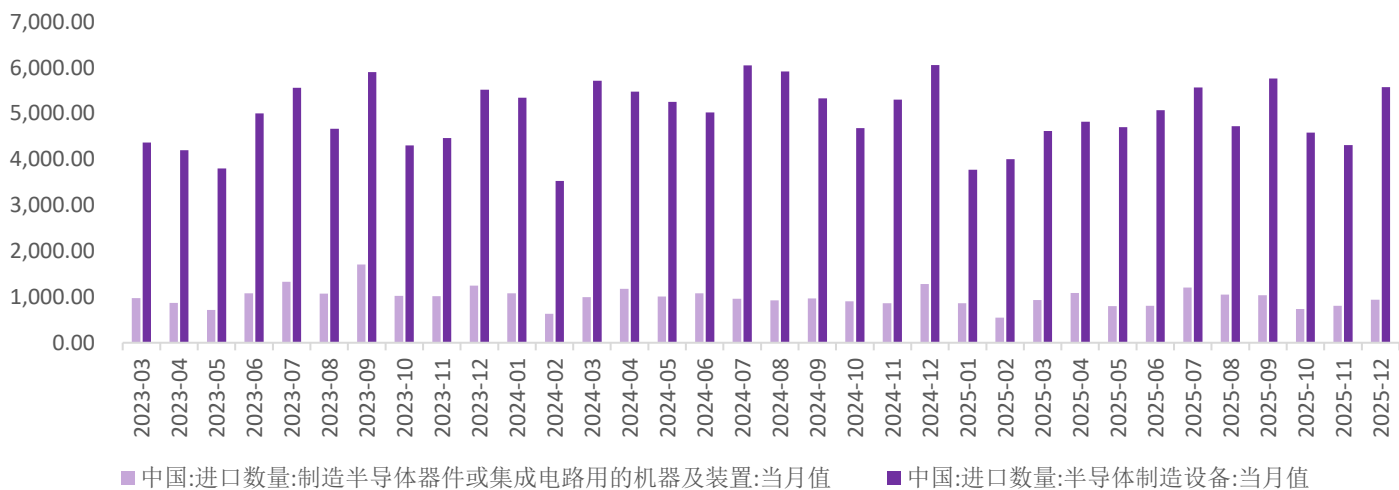
图表 14：全球半导体设备销售额（十亿美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

从中国进口半导体设备数量的维度来看，2023 年以来，中国的半导体设备进口数量整体呈现平稳的态势。结合上文中国大陆半导体设备销售额攀升的趋势，我们认为国产设备正在逐步提升市场份额。

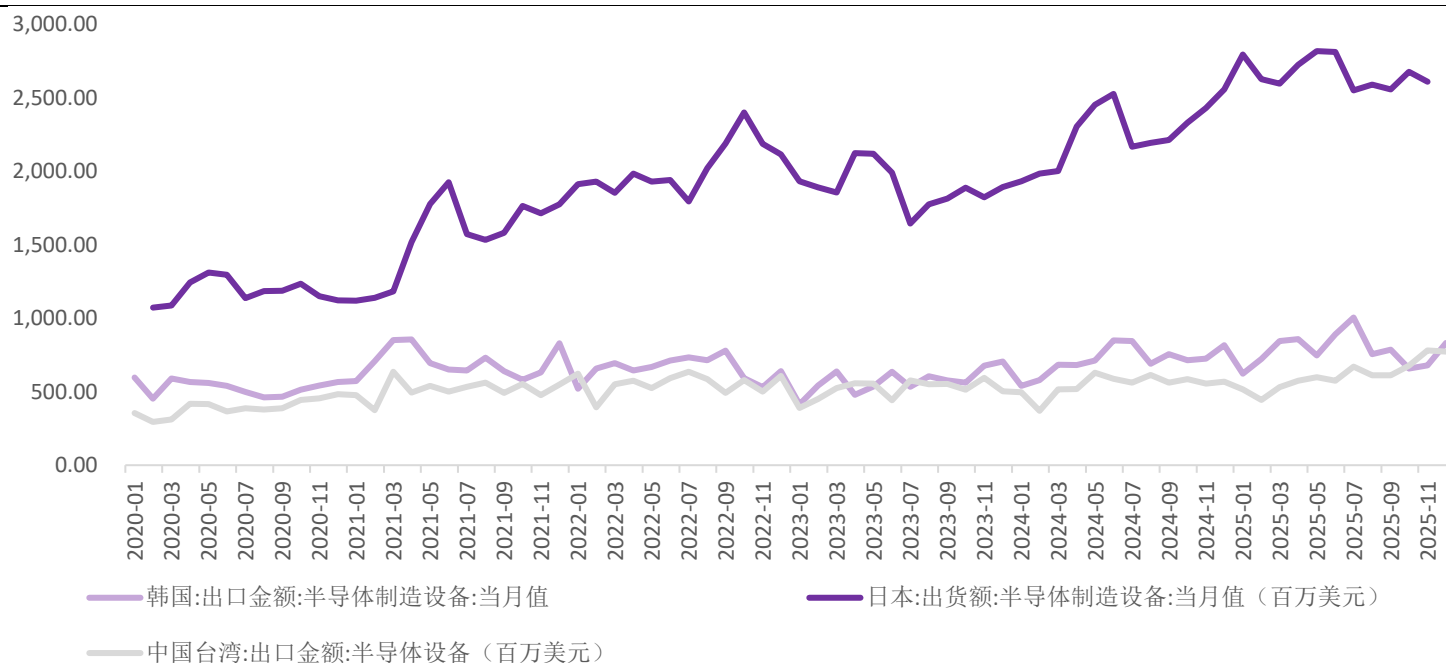
图表 15：中国半导体设备及制造半导体器件或集成电路用装置进口数量（台）



资料来源: wind, 华鑫证券研究

从海外市场半导体设备出口额的维度来看, 2019 年以来, 韩国和中国台湾的半导体设备出口金额整体维持平稳的态势, 日本半导体设备出口额呈现上升趋势。

图表 16: 海外市场半导体设备出口金额 (百万美元)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

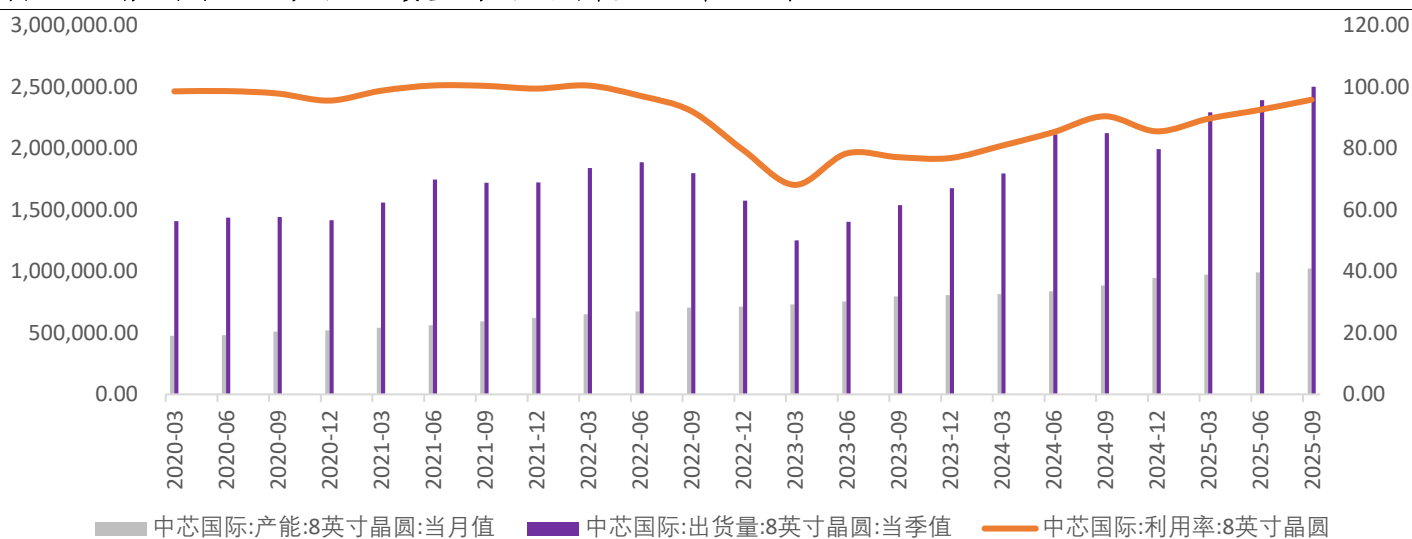
晶圆制造方面, 2018 年至 2025 年 9 月, 国产晶圆代工厂商中芯国际 8 英寸晶圆月产能从约 45 万片稳步提升至约 102.3 万片, 实现翻倍以上增长, 并历经稳步爬升、加速扩张及快速扩产三个阶段, 尤其在行业调整期间中芯仍坚持逆周期布局, 为后续复苏储备了充足产能。

产能利用率清晰地映射行业周期, 从 2020-2022 年高景气期多次超过 100%, 到 2023 年

下行期下滑至 68.1%，随后自 2023 年第三季度起强劲反弹，至 2025 年第三季度已恢复至 95.8% 的高位，接近满产状态。在产能大幅扩张与利用率快速回升的共同推动下，季度出货量规模显著跃升，2025 年第三季度达到近 250 万片，创历史新高，即便利用率未及上轮峰值，实际产出总量已远超以往。

整体来看，国产品圆代工厂通过逆周期扩产把握了复苏机遇，出货规模的突破体现规模效应增强，也印证了汽车电子、工业控制、物联网等领域对成熟制程芯片需求的持续性与增长潜力。

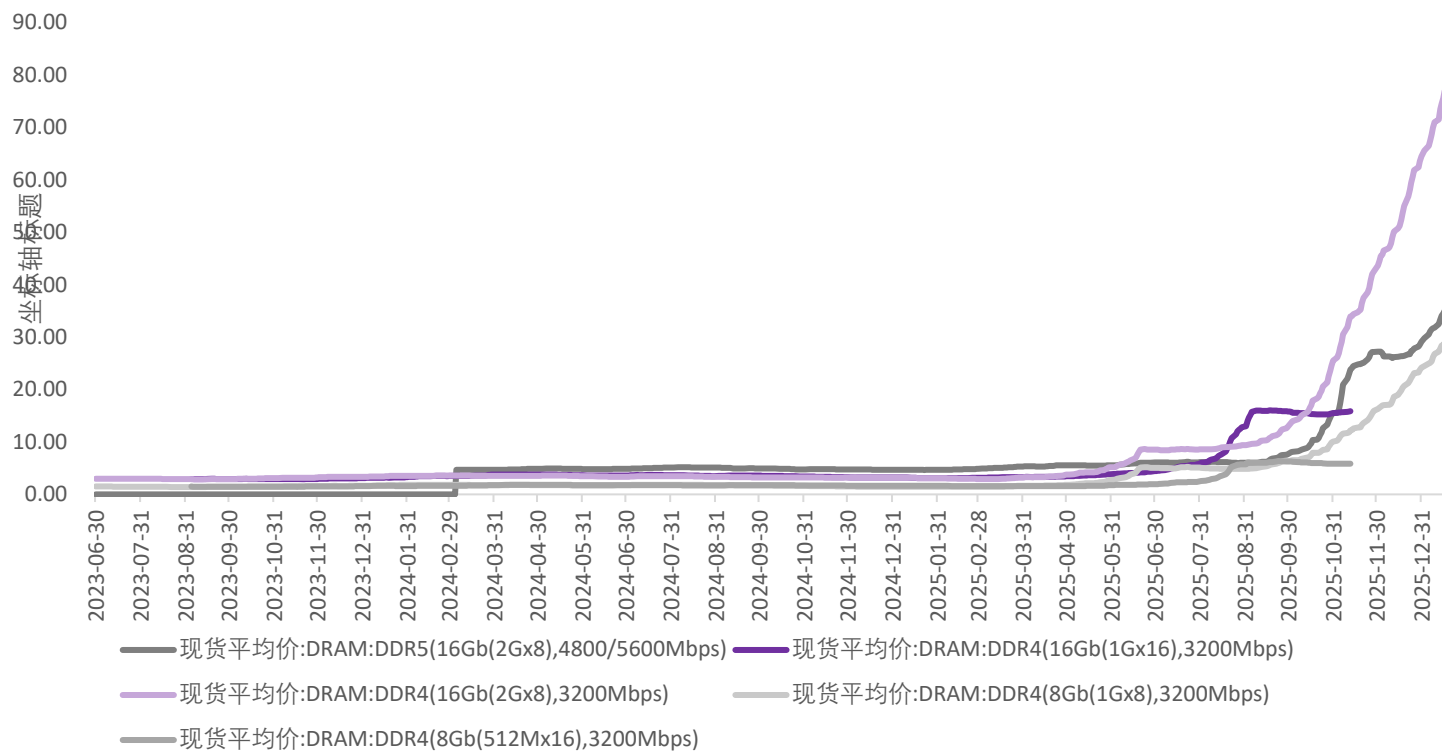
图表 17：国产品圆代工厂产能、出货量、产能利用率数据（单位：片）



资料来源：wind，华鑫证券研究（注：主坐标轴为产能和出货量，次坐标轴为产能利用率）

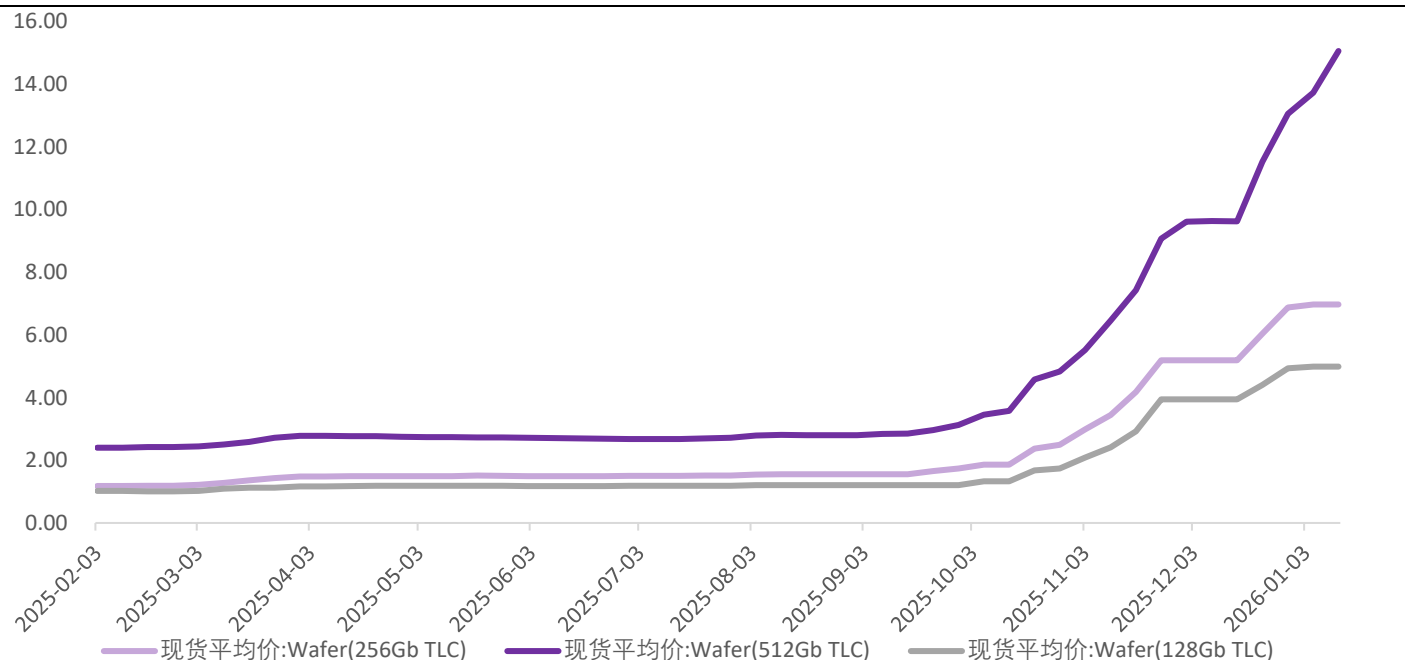
存储芯片方面，由于 AI 存力需求提升以及海外大厂产能切换 HBM 等缘故，导致传统 DRAM 以及 NAND 类存储芯片价格大幅攀升。NAND 方面：Wafer:512GbTLC 现货平均价从 2024 年 3 月底进入小幅回升，10 月出现小幅下跌后变化趋于平缓，2025 年 3 月以来小幅上涨，4 月后价格略有下滑，7 月后价格进入加速上涨阶段。2026 年 1 月 12 日价格为 15.05 美元。DRAM 方面：DRAM:DDR5 (16Gb (8Gx2), 4800Mbps) 现货平均价从 2024 年 3 月以来价格小幅上涨，9 月之后呈现小幅下跌态势，9 月之后又重回下跌态势，2025 年 1 月以来呈现大幅上涨的态势，12 月初出现小幅下跌，之后开始进入加速上涨阶段。2026 年 1 月 16 日价格为 35.00 美元。

图表 18：DRAM 价格（单位：美元）



资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 19: NAND 价格 (单位: 美元)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

## 4、行业动态

### 4.1、存储

#### 兆易创新与奇瑞汽车签署战略合作 共推“芯车协同”新范式落地

2026年1月12日，国内领先的芯片设计企业兆易创新与自主品牌领军汽车制造商奇瑞汽车正式签署战略合作协议，双方将建立长期稳固的战略伙伴关系，聚焦车载芯片全价值链深度协同，共同打造面向AI时代的下一代智能汽车系统解决方案，为中国汽车产业智能化跃迁注入核心动力。

根据协议，双方将整合各自核心优势，聚焦车规级芯片与下一代电子电气架构的协同创新。合作将率先发力智能座舱、自动驾驶等核心智能化场景，打通从芯片定义、联合开发、车规验证到规模化量产应用的全链路，加速创新技术商业化落地，打造行业标杆产品与解决方案。这一合作标志着双方将从过往的单点产品合作，升级为系统级深度协同的战略伙伴关系。

兆易创新作为 Fabless 芯片设计企业，已在车规级存储与微控制器（MCU）领域形成规模化应用能力。此前，兆易创新 GD25F128F 芯片已成功应用于奇瑞瑞虎 9、星途瑶光等车型的悬架控制器，充分验证了产品可靠性。此次合作中，兆易创新将持续提供高性能、高可靠性的车规级芯片产品及整体解决方案。奇瑞汽车则依托“技术立企”战略，在整车平台研发、系统集成与市场洞察方面具备深厚积淀。合作中，奇瑞汽车将为芯片顶层设计、精准定义、性能优化提供关键输入，并提供整车级验证保障，助力芯片更好适配复杂用车场景。

#### 传 SK 海力士考虑退出消费级存储市场

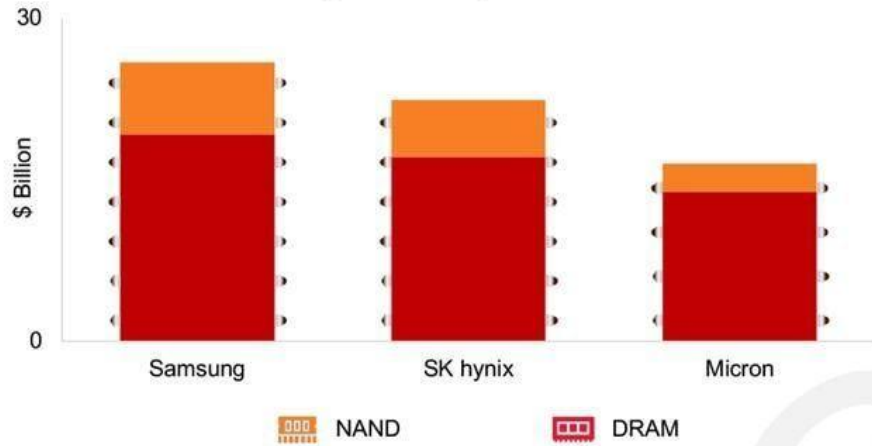
中国存储网消息，继美光（Micron）于去年底宣布将逐步关停消费级品牌英睿达（Crucial）后，全球消费存储市场可能将再受重击。近日，根据市场信息，另一大内存巨头 SK 海力士（SK Hynix）正考虑退出利润微薄的消费级 DRAM 与 NAND 闪存业务。尽管该消息尚未得到公司官方证实，但已在产业链内引发广泛关注与担忧。

消费存储市场主要指面向个人电脑（PC）、智能手机等终端设备的标准化内存与存储芯片，其特点是需求波动大、价格竞争激烈，利润率远低于供不应求的企业级存储如 HBM（高带宽内存）和服务器 DRAM。SK 海力士一直有消费市场产品，主要是为电脑、手机等终端设备提供内存（DRAM）和闪存（NAND）芯片，虽然它不直接以 SK 海力士品牌销售给普通消费者，但其芯片是众多知名品牌（如苹果、戴尔等）产品的重要组成部分。

此前，美光已宣布计划于 2026 年 2 月停产消费类 DRAM，标志着其战略重心向高利润领域转移。若 SK 海力士此番跟进，意味着全球三大存储原厂中的两家都将收缩或放弃消费级通用产品线。SK 海力士是目前全球第二大消费类内存供应商，其若退出，将对全球供应链产生连锁反应。三星电子（Samsung）将成为几乎唯一的全球性消费级存储芯片巨头，市场集中度显著提升，议价能力增强。

图表 20：市场主要公司存储营收对比

## Comparison of Memory Revenue of Major Players in Q4 2025



资料来源：CHINASTOR，华鑫证券研究

### 存储涨价趋势持续 多家上市公司宣布扩产计划

受 AI 算力需求爆发影响，存储芯片产能供应吃紧，价格大幅上涨。近期，多家国产存储芯片企业相继公布扩大产能项目，计划加大研发投入。

1 月 12 日，市场研究机构 Counterpoint Research 发布报告显示，存储市场行情已经超过 2018 年的历史高点，供应商议价能力已达到历史最高水平，预计 2026 年第一季度市场价格还将上涨 40%至 50%，第二季度继续上涨约 20%。存储芯片广泛应用于服务器，以及个人电脑、智能手机等电子产品。有媒体近日报道，以 256G 的 DDR5 服务器内存为例，其单条价格已超过 4 万元，如果按 1 盒 100 条计算，一盒产品价格已超过上海部分房产。TrendForce 集邦咨询调查报告显示，存储芯片上涨带动下游电子消费品价格上涨。终端产品面临成本考验，智能手机、个人电脑预计将上修产品价格、调降规格。

存储芯片涨价的推动力来自于 AI 算力需求爆发。集成电路封测企业通富微电在近期公告中提到，在 AI 大模型推理及边缘侧智能化发展带动下，市场对高带宽、高容量、高可靠性的存储产品需求快速上行。同时，传统应用如个人电脑、手机等产品亦呈现出更新迭代快、结构性升级的趋势，推动存储市场价格增长。上述因素共同导致 2025 年以来存储市场出现供不应求的局面。

2025 年以来，存储厂商开始逐步增加资本支出，通过新建厂房、新投设备，以及升级改造老制程设备等方式，提高存储产能。“但厂房的建设以及产线的调试量产需要较长时间，预计存储产能供应会在 2027 年下半年有所缓解。”王旭东称，国内厂商正积极扩展产能，同时投入高端存储技术研发，终端厂家也在增加国产存储器件的采购占比，国内存储厂商有望进一步提升市场份额。

多家上市公司近期披露研发、扩产计划。天山电子在 1 月 12 日披露，公司通过武汉鼎典投资新存科技和天链芯，战略性投资布局“存储芯片研发与制造-主控芯片与内存模块研发-内存模块制造-市场商业化拓展”垂直整合全链条，并计划构建从 AI 算力底层支撑到智能终端应用的完整存储生态能力。长电科技在 1 月 9 日发布的投资者关系活动表中提到，晟碟工厂在 2025 年下半年运营进一步改善，长电科技与外方股东持续加大对工厂的联合投入，聚焦新产品的技术迭代与产能扩张。预计公司全年存储业务将保持快速增长。通富微

电近日发布公告，拟募资不超过 44 亿元用于项目建设，其中拟投入 8 亿元用于存储芯片封测产能提升项目。公告介绍，该项目建成后年新增存储芯片封测产能 84.96 万片，将有助于公司进一步扩大生产规模、优化产品结构、增强抗风险能力。

### 兆易创新港股上市

1 月 13 日，国内专用型存储芯片与微控制器（MCU）设计龙头兆易创新科技集团股份有限公司正式登陆香港联合交易所主板，发行价定为每股 162.00 港元，开盘价达 235.00 港元，涨幅达 45.06%，总市值突破 1637.40 亿港元。

根据兆易创新此前公布的配发结果，本次香港公开发售部分获得了 542.22 倍的巨额超额认购，国际发售部分亦获 18.52 倍认购。本次发行最终定价为每股 162 港元，位于价格区间（132-162 港元）上限。在行使超额配股权前，本次全球发售募集资金净额约为 46.84 亿港元。

根据弗若斯特沙利文报告，以 2024 年销售额计，兆易创新是全球唯一一家在 NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型 DRAM 和 MCU 四大领域均位列全球前十的集成电路设计企业。行业分析师指出，随着端侧 AI 算力需求爆发，边缘计算推动终端设备向智能化转型，兆易创新凭借“存储+MCU+传感器”的协同优势，有望在机器人、电动汽车、可穿戴设备等领域占据先机。此次赴港上市，兆易创新引入了包括小米集团、TCL 实业、OPPO 创始人陈明永旗下公司以及多家知名投资机构在内的基石投资者，合共认购约 3 亿美元股份。

公司此前公告表示，本次发行 H 股所募集的资金在扣除发行费用后，将主要用于增强研发能力、进行战略投资与并购、建设全球营销网络以及其他一般公司用途。成功登陆港交所，有助于公司进一步提升国际品牌影响力，拓宽融资渠道，加速其全球化发展战略。在全球半导体产业竞争加剧与国产化替代持续推进的背景下，兆易创新作为行业龙头，其“A+H”双资本平台的建成，将为公司技术迭代、产能扩张和生态构建提供更为坚实的资本支撑。

### 闪迪要求 100% 现金预付款锁定 SSD 配额，野村证券发涨价预警

在人工智能技术飞速发展的推动下，全球存储市场正经历一场前所未有的供需剧变。作为存储芯片行业的领军企业，闪迪（SanDisk）近期提出了一项引发行业震动的供应合同策略，并计划大幅上调企业级固态硬盘（SSD）的价格，这一系列举措标志着存储市场正式进入卖方主导的超级周期。

据供应链，闪迪已向部分下游客户提出了一项前所未有的供应合同：要求客户支付 100% 现金预付款，以锁定未来 1 至 3 年的存储芯片配额。这一条款彻底打破了半导体供应链通常采用的分期付款或信用账期惯例，对买方的现金流提出了极端挑战。尽管这一条款极为严苛，但在 AI 基础设施建设对存储设备产生“刚性需求”的背景下，部分急需扩充算力的云服务供应商不得不考虑接受这一条件，以规避未来的断供风险。闪迪还将此类合同谈判范围扩大到了 PC、智能手机及模组厂商，试图在全产业链范围内巩固其市场地位。

除了付款方式上的强硬，闪迪还计划在未来几个月内大幅上调企业级 SSD 的价格。野村证券在最新的客户报告中明确指出：“闪迪用于企业级 SSD 的 NAND 报价，在 3 月份期间可能环比上涨超过 100%。”这一涨价计划归因于短期内的供应短缺以及 AI 领域对服务器级存储的中期需求增长。多家存储供应商也在持续推高价格，其中企业级 NAND 的涨幅尤为激进。野村证券的分析显示，闪迪面向企业 SSD 的 NAND Flash 价格有望在 3 月份环比涨价超过 100%，这一趋势已经得到了市场数据的验证。

闪迪的强硬举措迅速在市场上引发了连锁反应。美股市场上，闪迪股价再度大涨，续创历史新高。自去年 4 月下旬以来，闪迪股价累计涨幅超过 1100%，成为存储芯片板块的领头羊。其他存储概念股如美光科技、西部数据、希捷科技等也纷纷跟涨，显示出市场对存储行

业前景的乐观预期。然而，对于下游企业而言，成本压力正沿着产业链向下传导。消费级 SSD 和内存条的价格已出现大幅上涨，部分产品价格在数月内翻倍，甚至出现了“一天一个价”的现象。PC、智能手机等终端制造商已开始考虑上调产品售价或调整产品存储配置来应对成本上升的挑战。

### **NOR Flash 一季度将涨价 30%，传统存储芯片短缺比市场预期更久**

1 月 16 日消息，知名投行摩根士丹利在最新的研究报告中指出，尽管市场对传统存储仍存疑虑，但随着供需缺口进一步扩大，2025 年第二季至 2026 年将迎接新一波超级周期。报告强调，DDR4、DDR3、NOR Flash 以及 SLC/MLC NAND 等产品的供给吃紧状况正持续加剧，目前完全没有理由转向悲观。

报告指出，由于先进制程的存储产品产能需求强劲，持续排挤成熟制程的产能分配。第一梯队的企业买家在 2026 年 1 月份对 DDR4 的采购态度转趋积极，试图抢占额外的出货额度。但是在供应受限的情况下，预计第一季 DDR4 的价格涨幅可能高达 50%，且这股涨势将延续至第二季。此外，由于产能从 DDR3 转向 DDR4，导致高密度 DDR3 产品出现严重短缺，进而带动 DDR3 供应商的业绩追赶。

至于在闪存芯片领域，供应链的调整同样引发了显著的价格波动。报告指出，预计第一季 NOR Flash 的报价将调升 20-30%，且涨价趋势有机会延续至 2026 年下半年。而常规 NAND Flash 由于供应量的大幅缩减，第一季 MLC 与 SLC NAND 的价格涨幅预期将超过 50%。摩根士丹利指出，某家美国主流供应商可能会减少产能，这为中国台湾供应商提供了切入 AI 服务器供应链的良机。此外，高密度 SLC NAND 的价格涨势预计将在 2026 年第一季度跟上。

除了传统存储业务，部分成熟制程存储供应商正积极转型，共享高带宽内存（HBM）与先进封装技术的成长红利。报告提到，力积电的 P5 晶圆厂具备 WoW（晶圆堆叠）与混合键合（Hybrid Bonding）的充足产能，这在 HBM4e 标准下将变得至关重要。同时，爱普（AP Memory）有望受惠于主要美国客户对 CoWoS-S 技术的需求，其硅电容（IPD）业务预计在 2026 年展现强劲成长。

最后，报告基于对 2025 至 2026 年获利成长及股东权益报酬率发展的预期，大摩全面调升了相关台系存储业者的目标股价。其中，华邦电子被列为该领域的首选标的，其目标价由新台币 88 元大幅上调至 130 元。其他如力积电目标价由新台币 41 元调升至 56 元。旺宏由新台币 48 元调升至 72.5 元。南亚科技由新台币 198 元调升至 298 元。爱普则由新台币 475 元调升至 555 元。

### **近 4 个月机械硬盘价格平均上涨了 46%**

1 月 16 日消息，在全球 AI 基础设施扩建浪潮之下，对于存储器的需求已经远超当前的供应能力，这不仅导致了 DRAM、NAND Flash 等存储芯片短缺、价格大涨，就连传统的机械硬盘（HDD）的供应也严重短缺。

根据德国媒体 ComputerBase 最新发布的研究报告显示，自去年 9 月以来，机械硬盘的价格也开始急剧上涨，市场上一些最受欢迎的型号涨幅最高达 60% 以上。ComputerBase 分析了市场上最受欢迎的 12 款主流机械硬盘的价格趋势，显示在过去 4 个月内，这些机械硬盘的价格平均上涨 46%。其中，希捷（Seagate）的 IronWolf NAS 系列、东芝的 Cloud Scale Capacity、西部数据的 WD Red 以及希捷的 BarraCuda 系列，价格均上涨了 23% 至 66%。

这一趋势在美国市场也是显而易见。一块仅 4TB 容量的 Seagate IronWolf 硬盘，2023 年初价格为 70 美元，现在价格已经上涨到了 99 美元。同样，8TB 型号几年前价格低至 130 美元，现在售价为 199 美元。与其同样 8TB 容量的西部数据的 Red Plus 现价也要 175 美元。

希捷标志性的 BarraCuda 24TB 硬盘，在促销活动中价格曾低至 239 美元，但现在在亚马逊上的价格高达 499 美元。

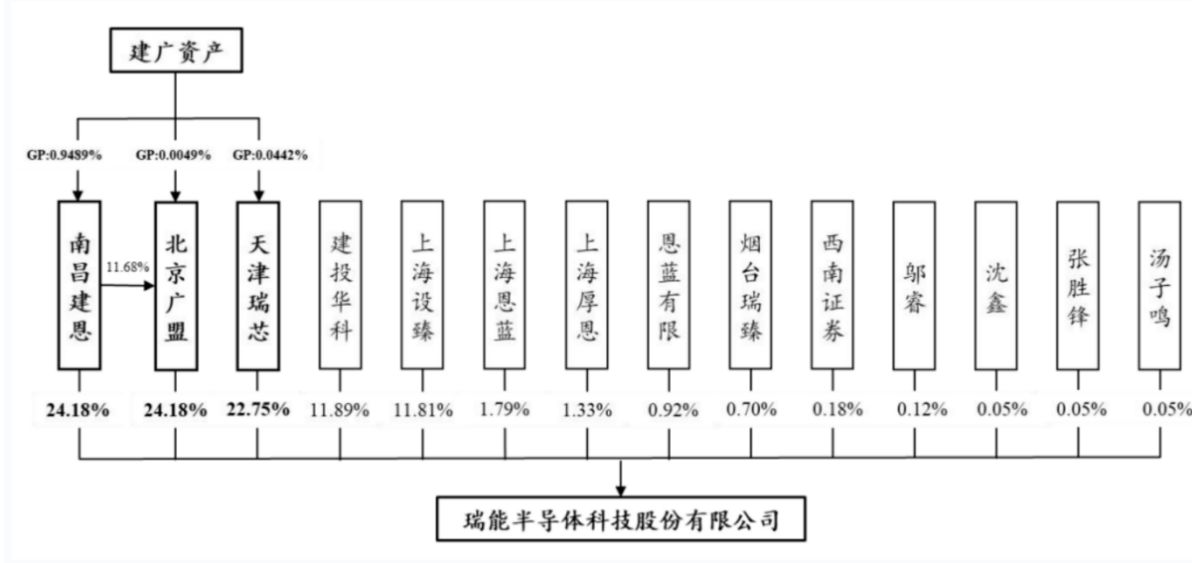
## 4.2、半导体

### 紫光国微拟收购瑞能半导 100%股权

1月14日晚间，紫光国微公布了收购瑞能半导 100%股权并募集配套资金的交易预案，拟通过发行股份及支付现金的方式向南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯、建投华科等 14 名交易对方购买其合计持有的瑞能半导 100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。根据公告显示，此次发行股份购买资产的股份定价为 61.75 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。但是，由于交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未确定。

紫光国微表示，通过本次交易，上市公司可整合功率半导体产品矩阵，快速补齐制造环节，完善功率半导体产业链布局，进一步巩固现有行业优势地位，增强公司在半导体产业的综合竞争力。此外，收购标的公司后，将整合双方技术、市场资源，加大在功率半导体领域的研发投入，加速高端功率器件的国产化研发与生产，把握国产替代历史发展机遇，降低我国相关产业对进口产品的依赖，为国家半导体产业安全提供有力支撑。此外，本次交易完成后，标的公司将成为紫光国微合并范围内的全资子公司，上市公司合并范围内的总资产、净资产、营业收入及净利润等主要财务数据预计将有所增长。

图表 21：瑞能半导体股权结构



资料来源：芯智讯，华鑫证券研究

### 美国政府正式宣布将中国台湾对美出口关税降至 15%

1月16日消息，美国政府正式宣布将中国台湾对美出口关税降至 15%，相比之前的约 20%税率进一步降低。但是，中国台湾半导体与科技企业需要至少对美国新增直接投资 2,500 亿美元，以扩大美半导体、能源及人工智能的生产与创新能力。美国商务部长卢特尼克 (Howard Lutnick) 与进一步指出，在特朗普总统任内，目标是将台湾整个半导体供应链产能的 40% 转移至美国。

美国商务部指出，除了中国台湾企业需要对美国新增 2500 亿美元的直接投资之外，中国台湾政府还将提供至少 2,500 亿美元的信用保证，以促进台湾企业对美国的进一步投资，支持在美国建立并扩大完整的半导体供应链与产业生态系统。

中国台湾经贸工作小组代表郑丽君表示，由于中国台湾是美国第六大贸易逆差地区，逆差中有高达 90%来自半导体、信息通信产品、电子零部件等，涉及美方 232 条款调查，因此中国台湾在谈判中聚焦对等关税并同 232 关税与美国贸易代表署及商务部进行多轮磋商，并在这次顺利达成谈判预定的四项目标。

只要中国台湾半导体厂商承诺在美国设厂，在建厂期间，就可以免除半导体进口关税，“这是专门为他们（台湾）量身设计的”。在美国商务部核准下，就可以进口相当于建厂产能 2.5 倍的半导体。

卢特尼克还指出，总部位于中国台湾但不在美国建厂的芯片公司可能面临 100%的关税。在特朗普总统任内，目标是将中国台湾 40%的半导体供应链转移到美国。而早在 2025 年 9 月，卢特尼克就提到，他将持续对中国台湾游说芯片制造“五五分”的构想，也就是美国和中国台湾各生产一半。

卢特尼克表示，台积电已购买土地，并将在亚利桑那州进一步扩建，这也正是与中国台湾关税协议的一部分。“他们刚在现有厂区旁买了数百英亩的土地。我会让他们按照董事会程序推进，并给他们一些时间。”

台积电董事长魏哲家在昨天的四季度法说会上也表示，目前台积电已加速美国亚利桑那州晶圆厂产能扩充计划，并顺利执行了相关计划，首座晶圆厂已于 2024 年第四季成功进入高量产阶段；第二座晶圆厂建造已完成，设备搬迁与安装计划于 2026 年进行。为应对客户强劲需求，加护提前生产，预计将于 2027 年下半年进入高量产阶段；至于第三座晶圆厂已开工建造，台积电也正申请第四座晶圆厂及首座先进封装厂的建造许可。

### 摩尔线程 MTT S5000 千卡集群完成智源具身大脑模型全流程训练

随着具身智能成为人工智能的下一个战略高地，底层算力底座的自主可控显得尤为关键。近日，摩尔线程联合北京智源人工智能研究院基于 FlagOS-Robo 框架，依托 MTT S5000 千卡智算集群，成功完成智源自研具身大脑模型 RoboBrain 2.5 的全流程训练。

通过面向多元芯片的统一 AI 系统软件栈 FlagOS 与 MTT S5000 硬件集群的高效协作，该解决方案不仅“能训”，而且实现了“训得稳、训得快”，为具身智能从实验室走向产业落地提供了坚实底座。

为了检验模型算法效果，智源团队在 2D/3D 空间感知推理榜单、时序价值评估榜单等多个权威具身评测数据集上进行了验证。结果显示，基于 MTT S5000 国产千卡训练出的 RoboBrain-2.5 模型，在多项关键指标上均与国际主流 GPU 训练模型保持一致。特别是在 CrossPoint、Q-Spatial、VABench-V 任务上，算法效果表现更优。这种全面对齐的评测结果，表明 FlagOS-Robo 框架与 MTT S5000 算力协同训练出的“具身大脑”，在理解、规划和执行能力上已达行业一流水准。

在模型精度方面，基于 MTT S5000 的夸娥智算集群表现出极高的稳定性。训练曲线显示，MTT S5000 千卡集群上的 Loss 走势与国际主流 GPU 训练结果高度重合，相对误差小于 0.62%。这一低误差表明国产算力训练准确性的同时，智源 FlagOS-Robo 框架成功实现了跨平台的无损迁移，开发者无需担心硬件更换导致的模型性能下降，真正做到了“代码不改、精度不降”的平滑适配。

大规模集群训练的核心在于效率。本次训练实测数据显示，摩尔线程 MTT S5000 千卡智算集群展现了较高的扩展能力：从 64 卡扩展至 1024 卡，系统实现了 90%以上的线性扩展效率。扩展曲线呈现出极佳的线性增长趋势，这意味着随着算力资源的增加，训练速度几乎同步倍增，充分证明了国产集群在大规模并行计算和通信调度上的成熟度，并具备支持万卡级训练的能力。

## 8英寸晶圆代工集体涨价！涨幅最高20%！

1月14日消息，市场研究机构TrendForce近日发布最新报告指出，随着台积电、三星电子降低8英寸晶圆代工产能，将导致2026年全球8英寸晶圆代工总产能同步减少2.4%。与此同时，人工智能（AI）驱动电源管理相关成熟制程芯片的需求依然强劲，使得8英寸晶圆代工厂今年产能利用率有望提升到90%。此消彼长之下，8英寸晶圆代工厂今年或将调高报价5%至20%。

从具体厂商来看，晶圆代工龙头大厂台积电在2025年8月宣布，两年内逐步退出6英寸晶圆制造业务，并持续削减8英寸晶圆产能。目前，台积电在中国台湾还有四座8英寸晶圆厂和一座6英寸晶圆厂，如果要在2027年全面退出，那么2026年就需要持续削减产能。目前台积电的8英寸晶圆代工月产能约为52.8万片。

三星电子同样于2025年下半年启动8英寸晶圆厂减产，且态度更为积极，希望将更多的资源投入到12英寸晶圆市场的竞争当中。而早在2024年底之时，三星为了应对持续亏损的晶圆代工业务以及8英寸晶圆厂的低产能利用率，就已经开始计划削减8英寸晶圆厂规模，并对8英寸代工制造和技术团队裁员30%以上。目前三星电子的8英寸晶圆代工月产能约为52.8万片。

联电旗下8英寸晶圆月产能曾超36万片，现阶段产能利用率约70%。展望后市，联电正向看待2026年营运有望延续成长轨迹。面对产业变局，该公司不与先进制程大厂正面对决，而是选择通过深耕特殊制程技术来巩固市占率。中芯国际目前在上海、北京、天津、深圳建有3座8英寸晶圆厂和4座12英寸晶圆厂。根据中芯国际2025Q3财报显示，其第三季产能利用率已升至95.8%，环比增长了3.3个百分点。截至2025年第三季度，中芯国际折合8英寸突破100万片月产能大关。其中，8英寸晶圆代工月产能约为35.5万片，2025年四季度8英寸产能利用率已高达96%。2025年12月，有业内信息显示，由于产能利用率持续处于高位，中芯国际已经针对部分产能涨价约10%。

华虹半导体2025年第三季总体产能利用率更是达到惊人的109.5%，呈现超负荷运转状态。华虹半导体表示，旗下3座8英寸晶圆厂的利用率持续维持在高位，而首座12英寸晶圆厂的实际投片量已突破每月10万片的设计产能。因此，为了应对持续涌入的订单，华虹正积极扩充产能。目前另一座处于产能处于增长阶段的12英寸晶圆厂，预计将在2026年第三季完成整体产能配置。目前，华虹集团的8英寸晶圆代工产能约为19万片，8英寸晶圆代工产能利用率也已超100%。

力积电目前的8英寸晶圆厂月产能约12万片（包含新竹和竹南的Fab 8A、8B），当前产能利用率持续上升。借助存储芯片供应紧缺、价格上涨和逻辑制程产品复苏带动业绩增长，叠加在AI先进封装和电源管理IC等高附加价值产品方面的布局，力积电今年业绩有望大幅增长。

世界先进2025年年产能约345万片，其8英寸晶圆厂主要生产电源管理IC、显示驱动IC及分离式元件（MOSFET / IGBT / GaN）等元件。世界先进长期深耕电源管理领域，并在AI服务器与数据中心应用具备稳健的技术基础与精准的能力，有望在AI需求热潮当中实现业绩的进一步增长。

值得一提的是，一些头部的IDM大厂也在削减8英寸晶圆厂。2025年6月，据荷兰媒体报道称，恩智浦半导体计划关闭四座8英寸晶圆制造厂，一座位于荷兰，三座位于美国，这也是恩智浦向12英寸（300毫米）晶圆生产战略转型的一部分。

随着台积电、三星电子这两大晶圆代工厂削减8英寸晶圆产能，其他像格罗方德等厂商主要精力都放在12英寸晶圆厂扩产，TrendForce预计，2025年全球8英寸晶圆代工产能将同比下滑约0.3%，进入负成长走势；2026年尽管中芯国际、世界先进等业者规划小幅扩产，仍不及两大厂减产幅度，估产能的年度同比下滑幅度将扩大至2.4%。

TrendForce 预估，2026 年全球 8 寸晶圆代工厂平均产能利用率将升到 85%至 90%，明显优于 2025 年的 75%至 80%。部分晶圆厂看好今年 8 英寸厂产能将转为吃紧，已通知客户将调涨代工价 5%至 20%不等，与 2025 年仅针对部分旧制程或技术平台客户补涨不同，此次为不分客户、不分制程平台全面性调价。

## 5、重点公司公告

### 紫光国芯微电子股份有限公司董事会关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明

紫光国芯微电子股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买瑞能半导体科技股份有限公司 100%股权，并募集配套资金。本次交易中，交易对方南昌建恩半导体产业投资中心、北京广盟半导体产业投资中心和天津瑞芯半导体产业投资中心合计持有标的公司 71.11%股权，北京建广资产管理有限公司为以上主体的执行事务合伙人。截至本说明签署日，建广资产担任执行事务合伙人的其他合伙企业合计持有公司间接控股股东北京智广芯控股有限公司 13.75%股权，且建广资产与智广芯存在 2 名董事重合。公司间接控股股东新紫光集团有限公司和智广芯董事长李滨在过去 12 个月内曾担任瑞能半导董事长，李滨持有交易对方上海设臻技术服务中心 51.09%财产份额，且合计穿透持有瑞能半导 8.29%股权；公司董事长暨间接控股股东新紫光集团和智广芯董事陈杰通过交易对方天津瑞芯间接持有瑞能半导 0.75%股权；交易对方邬睿为公司董事并持有瑞能半导 0.12%股权。

### 希荻微关于 2024 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

根据希荻微电子集团股份有限公司发布的公告，因公司计划披露 2025 年年度业绩预告，依据相关规定，现对其 2024 年股票期权激励计划设置限制行权期。其中，首次授予部分的第一个行权期为 2025 年 5 月 22 日至 2026 年 3 月 27 日，预留授予部分的第一个行权期为 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 7 月 24 日。公司明确，在 2026 年 1 月 26 日至 2026 年 1 月 30 日期间，全部激励对象将被限制行权，并将按规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关事宜。

### 常州中英科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。常州中英科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日发布《关于股东减持股份预披露的公告》，持有公司股份 2,436,000 股（占公司总股本比例的 3.2394%）的公司控股股东、实际控制人的一致行动人常州中英汇才股权投资管理中心计划自减持股份预披露的公告之日起 15 个交易日后 3 个月内进行通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 118,300 股。截至 2025 年 11 月 5 日，中英汇才已减持 98,200 股，占公司总股本比例为 0.13%，减持计划已实施完成。此外，公司于 2025 年 11 月 7 日发布《关于股东减持股份预披露的公告》，持有公司股份 580,000 股（占本公司总股本比例的 0.7713%）的公司控股股东、实际控制人的一致行动人马龙秀女士计划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 580,000 股，即不超过公司总股本的 0.7713%，减持期间自减持股份预披露的公告之日起 15 个交易日后 3 个月内进行。近日公司收到马龙秀女士出具的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的告知函》，马龙秀女士通过集中竞价交易方式减持公司股份 84,800 股，占公司总股本比例为 0.11%，本次权益变动后，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份 44,368,000 股，占公司总股本比例为 59.00%，权益变动触及 1%整数倍。

### 浙江蓝特光学股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划

为完善分红决策机制并积极回报投资者，浙江蓝特光学股份有限公司根据相关法律法规及《公司章程》，制定了《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。该规划着眼

于公司长远发展，综合分析经营状况、股东意愿、资金需求等因素，确立了持续、稳定、透明的利润分配原则，明确以现金分红为主、优先于股票股利，并设定了每年现金分红比例不低于当年可分配利润 10%的基础要求。同时，规划依据公司不同发展阶段与资金安排，差异化设定现金分红最低比例，并建立了相应的决策、审议程序及调整机制，以保障利润分配政策的连续性与稳定性，切实维护股东特别是中小投资者的权益。

## 6、风险提示

- (1) 半导体制裁加码
- (2) 晶圆厂扩产不及预期
- (3) 研发进展不及预期
- (4) 地缘政治不稳定
- (5) 推荐公司业绩不及预期

## ■ 电子通信组介绍

**吕卓阳：**澳大利亚国立大学硕士，曾就职于方正证券，4 年投研经验。2023 年加入华鑫证券研究所，专注于半导体材料、半导体显示、碳化硅、汽车电子等领域研究。

**何鹏程：**悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所通信组，2023 年加入华鑫证券研究所。专注于消费电子、算力硬件等领域研究。

**张璐：**早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023 年加入华鑫证券研究所，研究方向为功率半导体、模拟 IC、量子计算、光通信。

**石俊焯：**香港大学金融硕士，新南威尔士大学精算学与统计学双学位，研究方向为 PCB 方向。

## ■ 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

## ■ 证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	> 20%
2	增持	10% — 20%
3	中性	-10% — 10%
4	卖出	< -10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	> 10%
2	中性	-10% — 10%
3	回避	< -10%

以报告日后的 12 个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

**相关证券市场代表性指数说明：**A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。

## ■ 免责声明

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。